

Anmeldung

Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung (bis zum 30.06.2017) im Internet unter

www.pronto-microtec.de

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Wir freuen uns über Ihr Kommen.

Kontakt und Organisation

Dr. Christine Harendt (IMS CHIPS),
Telefon: 0711 / 218 55 – 403
E-Mail: info@pronto-microtec.de
Internet: www.pronto-microtec.de

Adresse

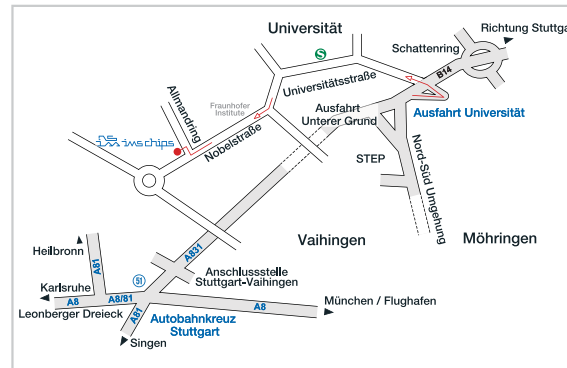
Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS CHIPS)
Allmandring 30 a, 70569 Stuttgart
www.ims-chips.de

 Hahn-Schickard, www.hahn-schickard.de

 IMS CHIPS, www.ims-chips.de

 NMI, www.nmi.de

Anreise



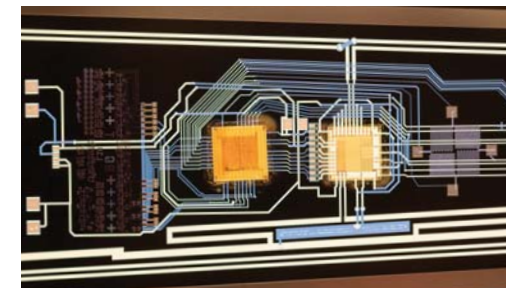
Anreise mit dem PKW

Verlassen Sie die Autobahn A8/A81 am Kreuz Stuttgart in Richtung Vaihingen. Nehmen Sie die Ausfahrt Universität. Folgen Sie dem Verlauf der Universitäts- / Nobelstraße, vorbei an den Fraunhofer Instituten, biegen Sie rechts in dem Allmandring ein und fahren Sie in die erste Einfahrt auf der linken Seite. Parkplätze finden Sie vor dem Tor und etwas bergab hinter dem Tor direkt im Bereich des IMS-Hauptgebäudes.

Anreise mit der Bahn

Am Hauptbahnhof Stuttgart S-Bahn Linie S1 (Richtung »Böblingen, Herrenberg«) oder S2, S3 (Richtung »Vaihingen, Flughafen, Filderstadt«) nehmen. Fahrtdauer 11 Min.
An der Haltestelle »Universität« aussteigen, Ausgang »Wohngebiet Schranne und Endelbang – Nobelstraße« benutzen.
Von hier den Bus Nr. 84 (Richtung Sindelfingen), oder Bus Nr. 91 (Richtung Sindelfingen) oder Bus Nr. 92 (Richtung Leonberg) bis »Nobelstraße« (2. Haltestelle) nehmen oder zu Fuß gehen (ca. 1,5 km) oder mit dem Taxi vom Hauptbahnhof fahren: Fahrtdauer ca. 30 Min., Fahrpreis ca. EUR 35,-.

Produktionsplattform PRONTO



Kalkulierbarer Einstieg in
die Mikroproduktion

PRONTO-Workshop

Dienstag, 4. Juli 2017

Institut für Mikroelektronik Stuttgart
in Stuttgart

Produktionsplattform für Mikrosysteme

- Prototypenfertigung
- Kleinserien
- Produktionsanlauf
- Industriequalität

PRONTO

... ist die Plattform zur **PRO**duktion von **Null**- und Kleinserien, **Technologisch kOMplexer** Mikrosysteme.

... wendet sich an Unternehmen, die eigene Ideen für Mikrosysteme in konkrete Lösungen umsetzen wollen und keine eigenen Entwicklungs- und Produktionsmöglichkeiten besitzen.

... stellt sicher, dass Produkte in hoher und reproduzierbarer Qualität entstehen und ermöglicht neben der Prototypenherstellung auch Kleinserienfertigung.

... unterstützt MST-Hersteller beim Aufbau und Serienanlauf eigener Fertigungslinien.

Kontakt PRONTO:

info@pronto-microtec.de
www.pronto-microtec.de



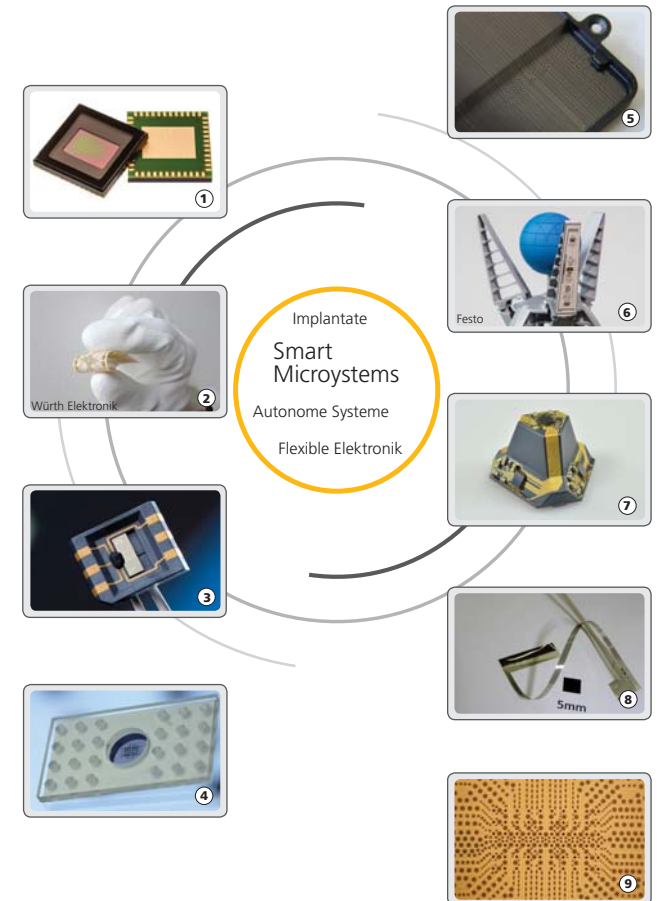
Programm

PRONTO-Workshop, 4. Juli 2017

Folienelektronik für intelligente Sensorik

Joachim Burghartz IMS CHIPS	Begrüßung und Institutsvorstellung IMS	10:00
Alexander Kaiser Cicor	Flexible Schaltungsträger in Dünnschicht- technik – Technologien und Anwendungen	10:20
Volker Bucher Hochschule Furtwangen	Folientechnologien für zukünftige Medizinanwendungen	10:40
Koen Hollevoet Rogers Corporation	Wenn Standard Laminatfolien nicht mehr ausreichen	11:00
	Kaffeepause	11:20
Axel Sikora Hahn-Schickard Stuttgart	Ende-zu-Ende Datensicherheit für intelli- gente Sensorik	11:40
Alois Friedberger Airbus Group Innovations	Anwendungen und Bedarf folienbasierter Sensorik bei der Herstellung von Flugzeugbauteilen	12:00
Andreas Ostmann Fraunhofer IZM	Konforme Systeme auf thermoplasti- schen Folien	12:20
	Mittagspause mit Postern & Exponaten	12:40
Cristian Nagel Robert Bosch GmbH	MEMS Accelerometers for flexible Electronics	13:40
Stefan Saller Festo AG & Co. KG	Flexible Elektronik und Sensorsysteme für die Anwendung in der Automatisierungstechnik	14:00
Thomas Meißner Hahn-Schickard Stuttgart	Integrationstechnologien für dünne Chips auf flexiblen Substraten	14:20
Alina Schreivogel Würth Elektronik GmbH & Co. KG	More Than Flexible – Neue Folientechno- logien in der Leiterplattenfertigung	14:40
Björn Albrecht IMS CHIPS	Flexible Multichipmodule durch adap- tives Layout	15:00
	Ende / Rundgang optional	15:20

LÖSUNGEN



- 1 Bildsensor im gemoldeten Package
- 2 Ultradünner Chip im flexiblen Schaltungsträger
- 3 Thermischer Strömungssensor in 3D MID-Gehäuse
- 4 TopSpot-Druckchip

- 5 Gedruckter Intrusionssensor
- 6 Biege- und Dehnungssensorsystem
- 7 MID (Molded Interconnect Device)
- 8 Flexibles Elektrodenarray (FlexMEA)
- 9 Elektrodenfeld eines perforierten Mikroelektroden Arrays (pMEA)